

[19]中华人民共和国专利局

[11] 公开号 CN 1108026A



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 94113752.X

[51] Int. Cl⁶

H05K 3/46

[43] 公开日 1995 年 9 月 6 日

[22] 申请日 94.9.20

[30] 优先权

[32] 93.9.21 [33] JP[31] 234519/93

[32] 93.9.29 [33] JP[31] 242450/93

[71] 申请人 松下电器产业株式会社

地址 日本大阪府

[72] 发明人 中谷诚一 畠山秋仁 川北晃司

十河宽 小川立夫

小岛环生

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 王忠忠 萧梅昌

H05K 3/42

Correspond to Japanese
application number H6-211074
which priority app. numbers are
above 234519/93 242450/93

说明书页数:

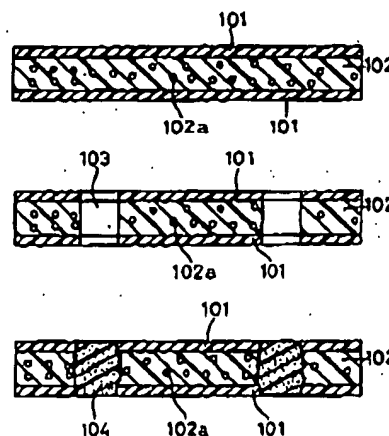
附图页数:

Best Available Copy

[54] 发明名称 电路基板连接件及用其制造多层电路基板的方法

[57] 摘要

电路基板连接件包括在两面设置无粘性薄膜的有机多孔基材及在所需位置设置的通孔, 其以导电树脂料填充直至无粘性薄膜的表面。此结构能使内通路孔连接, 因而可获得电路板连接件, 及高可靠性高质量的电连接件。由于采用包括在两面设有无粘性薄膜的有机多孔基材及在所需位置设置了通孔, 其以导电树脂料填充至无粘性薄膜表面的电路板连接件, 可以用相当稳定地制造的双面板或四层板容易形成高多层板。



(BJ) 第 1456 号